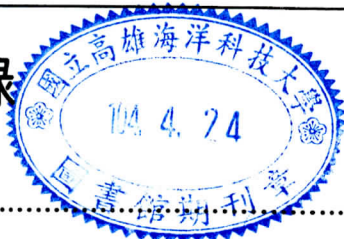


目 錄



1. 第三十八屆高分子學術研討會	42
2. 聚醯胺彈性體構造與性能	47
3. 精密射出成型技術	52
4. 橡膠老化原因探討	60
5. 印刷電路板基材用高分子材料發展趨勢	66
6. 微粒子的表面處理技術	73
7. 奈米塑膠的特性	80
8. 橡膠加工及處理用押出機	85
9. 用填充劑與彈性體改良塑膠材料物性	91
產官學專欄	95

發行人：謝立生

出版登記：行政院新聞局局版台誌字第4900號

編輯人：本刊編輯委員會

印刷者：福村美術印刷廠有限公司

出版者：高分子工業雜誌社

社務顧問：林永瑞

地址：台北市中正區羅斯福路一段10號604室

電話：02-23964083，0922414227，傳真：02-23942691

郵政劃撥：1030867-5 帳戶：高分子工業雜誌社 一年期 1800元

E-mail: lisun117@yahoo.com.tw

http://tw.myblog.yahoo.com/lisun117

香港地區訂購請洽：廣彙貿易公司期刊部 TEL:25420245

中華郵政臺字第一八二五號執照登記為雜誌交寄